



# ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

## 二零零三年未經審核中期業績公佈 截至二零零三年六月三十日止六個月

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 董事會欣悅地宣佈二零零三年中期業績如下：

### 業績

截至二零零三年六月三十日止六個月，集團錄得營業額為港幣1,076,926,000元，與去年同期的港幣826,728,000元相比增長百分之三十點三，與較前六個月的港幣1,019,288,000元相比有百分之五點七的增長。集團綜合除稅後溢利為港幣190,595,000元，相比去年同期增長百分之四十點八。期內每股基本溢利為港幣0.50元（二零零二年：港幣0.35元）。

### 派息

董事會已議決派發中期股息每股港幣0.36元（二零零二年：港幣0.36元）。此派息政策乃貫徹集團於公佈二零零二年度業績時明確指出將過剩現金回饋予股東的審慎決定，並預留適量的股本作營運之用。

集團將於二零零三年八月十八日至八月二十五日，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派是次中期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零零三年八月十五日下午四時前，送達香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下公司股份登記處秘書商業服務有限公司。中期股息將於二零零三年八月二十六日左右派發。

## 財務概要

		截至六月三十日止六個月	
		二零零三年 (未經審核) 港幣千元	二零零二年 (未經審核) 港幣千元
	附註		
營業額	1	<b>1,076,926</b>	826,728
銷貨成本		<b>(624,781)</b>	(487,028)
毛利		<b>452,145</b>	339,700
其他經營收益		<b>3,770</b>	3,380
銷售費用		<b>(100,268)</b>	(78,215)
一般管理費用		<b>(45,744)</b>	(39,617)
研究及發展淨支出		<b>(102,056)</b>	(81,345)
經營溢利		<b>207,847</b>	143,903
財務費用		<b>(46)</b>	(113)
除稅前溢利		<b>207,801</b>	143,790
稅項	3	<b>(17,206)</b>	(8,380)
本期間淨溢利		<b>190,595</b>	135,410
股息		<b>137,999</b>	137,364
每股溢利	4		
— 基本		<b>HK\$0.50</b>	HK\$0.35
— 攤薄		<b>HK\$0.50</b>	HK\$0.35

## 1. 分類資料

## 業務分類

	截至六月三十日止六個月	
	二零零三年 (未經審核) 港幣千元	二零零二年 (未經審核) 港幣千元
營業額		
設備	869,800	623,651
引線框架	207,126	203,077
	<u>1,076,926</u>	<u>826,728</u>
業績		
設備	190,834	109,763
引線框架	14,715	30,760
	<u>205,549</u>	<u>140,523</u>
未分配之公司收入	<u>2,298</u>	<u>3,380</u>
經營溢利	207,847	143,903
財務費用	(46)	(113)
	<u>207,801</u>	<u>143,790</u>
除稅前溢利	207,801	143,790
稅項	(17,206)	(8,380)
	<u>190,595</u>	<u>135,410</u>
期間淨溢利	<u>190,595</u>	<u>135,410</u>

## 地區分類

	營業額	
	截至六月三十日止六個月 二零零三年 (未經審核) 港幣千元	二零零二年 (未經審核) 港幣千元
中國大陸	202,642	101,214
台灣	185,382	186,886
韓國	169,027	91,482
馬來西亞	122,499	101,043
菲律賓	83,823	48,412
新加坡	82,964	68,298
泰國	81,316	48,825
香港	53,804	65,856
印尼	30,296	22,077
歐洲	25,549	22,919
美國	19,747	42,009
日本	18,356	26,444
其他	1,521	1,263
	<u>1,076,926</u>	<u>826,728</u>

## 2. 折舊

於本期間內，集團的物業、廠房及設備之折舊為港幣七千五百九十萬元(二零零二年六月三十日止六個月為港幣七千七百七十萬元)。

## 3. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零零三年 (未經審核) 港幣千元	二零零二年 (未經審核) 港幣千元
稅項包括：		
香港利得稅	16,934	8,603
在其他司法權區之稅項	1,109	1,638
	<u>18,043</u>	<u>10,241</u>
遞延稅項抵免	(837)	(1,861)
	<u>17,206</u>	<u>8,380</u>

香港利得稅是按本期間內估計應課稅溢利以稅率百分之十七點五(二零零二年六月三十日止六個月為百分之十六)計算。

其他司法權區之稅項乃根據有關司法權區個別之現行稅率計算。

遞延稅項抵免主要是來自稅項折舊與計入財務報表之折舊費用之時間差距的稅務影響。

#### 4. 每股溢利

每股基本及攤薄溢利按以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零三年 (未經審核)	二零零二年 (未經審核)
	港幣千元	港幣千元
計算每股基本及攤薄溢利之 股東應佔溢利	<u>190,595</u>	<u>135,410</u>
	股份之數量(以千位計)	
計算每股基本溢利之 普通股加權平均股數	383,332	381,568
來自僱員股份獎勵制度之 潛在攤薄影響	<u>1,322</u>	<u>1,422</u>
計算每股攤薄溢利之 普通股加權平均股數	<u>384,654</u>	<u>382,990</u>

## 業務回顧

在環球經濟疲弱及伊拉克戰爭不明朗因素的陰影下，集成電路之需求或資本性投資並未如預期中受電子產品降價所刺激。儘管愈來愈多半導體公司和包裝公司 (Subcons) 的產量已超越其於以往高峰時的水平，客戶對於增加產能仍顯得格外審慎，且留待需求獲得確定後才落實。大部份的集成電路包裝設備訂單均屬於技術提升類別，例如微距焊線、300 毫米晶片管芯焊接、大量管芯包裝、覆晶片及新包裝類別如 QFN。雖然集團之訂貨與付運比率曾有數月在一之上，但前景仍然未明，而交貨期亦被縮短。總括而言，業內競爭激烈，市場環境仍然充滿挑戰。

ASM 平穩且持續地提升市場佔有率，尤其是在管芯焊機及焊線機市場領域，並在逐步改善的營商環境下於過去六個月錄得達一億三千八百一十萬美元之總營業額及理想的盈利。於截至二零零三年六月三十日止半年，集團的資本回報率及銷售利潤率分別為百分之十二點二及百分之十九點一。期末積存訂單上升至四千五百萬美元 (對比於二零零三年一月一日為三千五百萬美元)。我們五大客戶合共佔集團營業額百分之四十一點九，其中兩個客戶佔逾百分之十。

在今年首六個月，我們的設備及引線框架業務之營業額均反彈至超出各自過去四個半年結所錄得之水平，營業額分佈維持於以往的八十點八比十九點二（設備對比引線框架）。自二零零二年超越其他具領導地位的對手後，我們的裝嵌設備銷售於二零零三年上半年仍傲視同儕，充分反映我們在行業內的優越地位，並持續提升市場佔有率。此外，我們再一次被 *Advanced Packaging* 雜誌評選為焊接、塑封及包裝處理組別的「二零零三年高科技包裝獎冠軍」，充分顯示業界對 ASM 於技術層面的領導地位及集團的創新設備產品認同及肯定。

由於多間集成裝置製造商 (IDMs) 及包裝公司投放更多資源在中國，以及內地湧現許多成功企業，中國市場已於二零零三年首六個月成為 ASM 最大的銷售領域，佔集團營業額的百分之十八點八，亦是歷來最高的貢獻比率。預期於二零零三年的財政年度，ASM 在這個市場領域將可刷新另一個銷售紀錄。與此同時，我們位於中國福永的綜合引線框架新廠房已如期落成，並已於第二季開始投產，我們預期於今年至年底前將可分階段取替香港廠房餘下的電鍍業務，藉此大大縮短我們的生產週期，減少半製品，以及人事及租金支出。

ASM 的 Eagle 60 金線焊接機擁有較我們主要之對手更領先一代的35毫米微距焊線技術，成功在多項客戶基準測試中脫穎而出，令 ASM 贏得主要集成電路客戶的新訂單。於過去六個月，我們取得一家新加坡著名包裝公司對 Eagle 60 焊線機之量產訂單，以及來自一間美國十大半導體公司的首批訂單，以應付他們先進的 BGA 及 TQFP 包裝。隨著300毫米晶片的面世及大量管芯包裝的需求，我們高速而嶄新的集成電路管芯焊接機正逐步擴大市場佔有率及奠下鞏固基礎。從取得首批訂單的實例中証明了創新的產品，如覆晶焊接機及軟焊料晶片焊接技術，已成功為我們開拓從未涉足的新市場商機，從而強化了 ASM 在晶片焊接工序的領導地位。

儘管我們需要處理更多元化的產品種類及增加新產品及現有產品之半製品以滿足快速送貨的需求，我們的總存貨量仍然維持在港幣五億六千三百萬元之水平內，較六個月前的數字只多出百分之十一點三，但相對過去多個半年期結時的數字為低。未付銷售日數或應收賬項雖較以往回顧期為高，但主要由於近季度的銷售額有顯著上升所致。

在今年四月派發港幣二億四千五百三十萬元的去年末期股息及於上半年度支付港幣五千六百四十萬元的資本性投資後，集團於二零零三年六月三十日的手頭現金僅減少百分之三十七點六，達港幣二億九千零六十萬元（於二零零二年十二月三十一日為港幣四億六千五百六十萬元）。我們的流動比率為三點二，並沒有長期債項及銀行借貸，資本負債比率僅為百分之二十八點一。在沒有短期資金需要及由內部營運增長帶來的持續正現金流的情況下，ASM 維持高派息比率及回饋剩餘現金予我們的股東。

## 展望

隨著伊拉克戰爭不明朗因素及大中華區非典型肺炎之影響逐漸消除，再加上稅項寬減、美國政府實行振興經濟措施以及預期低息率將持續，根據 *Business Week* 於年中所作的經濟調查顯示，大部份美國經濟分析員預期由二零零三年中開始未來數季的國民生產總值將會提升(每年為百分之三點四至百分之三點八)。各行業分析員如 *Dataquest*, *VLSI Research*, *SIA*, *IC Insights* 及 *WSTS* 目前均預測半導體業於二零零三年之增長為百分之八至十三，而其後兩年則將有雙位數字增長(於二零零四年為百分之十七至三十六)。根據 *IC Insights* 預測，集成電路產量將有百分之十四點九之增長。有見晶體度包裝如 *QFN* 被應用於新一代的無線通訊及手提設備設計上，預期這將加快晶體度包裝之增長步伐。

至於裝嵌設備市場方面，儘管 *Dataquest* (預測增長百分之二十六) 及 *VLSI Research* (預測增長百分之九) 對於二零零三年的增長率有不同之預測，兩者均預期下半年的表現將較上半年強勁，而二零零四年更將出現雙位數字之增長(百分之二十四至三十六)。最近數月，股票市場對高科技公司之評價變得較為正面，有利我們的客戶獲取資金以支持他們的資本性開支，從而改善裝嵌設備市場之表現。

當我們大部份的競爭對手因負債比率高企或財務狀況疲弱而要以短線措施減少虧損及壓止現金外流，相反地 *ASM* 正進取地為未來發展而投資於設備、工序及產品研發。集團計劃於二零零三年的資本性投資為港幣一億六千萬，其中部份用作於第四季安裝蝕片生產線以提升生產能力，滿足我們 *QFN* 蝕片引線框架不斷擴展之需要。為鞏固我們與重要客戶之策略性夥伴關係，我們利用 *ASM* 的設備及引線框架為他們提供不同的包裝解決方案，包括多層管芯、影像感應組件、高亮度 *LED*、以銅線焊接的電源設備、*QFN* 包裝等。結合我們於晶片焊接、覆晶、焊線、塑封工序及引線框架設計的豐富知識，*ASM* 解決方案的銷售模式令集團於芸芸競爭對手中脫穎而出，開啟了那些不接受單一產品測試之客戶的大門。

先進晶片組裝要求低 *K* 電介體，更微細的管線闊度及銅線交接。為滿足此要求，*ASM* 以內部資源及與客戶和研究機構共同研發金線及銅線焊接工序。集團將於年內推出一款高產能的金線焊機，以提升我們的領導地位。同樣地，一款以線性馬達技術開發的微距鋁線焊機將於二零零三年年中面世，這將進一步鞏固 *ASM* 於軟包裝市場的主導地位。

憑藉我們針對不同應用市場的多元化產品、一系列備有出色工序及技術的新產品、以及最具成本效益結合產品設計及生產的垂直整合業務模式，集團於過去數年已奠下穩固的基礎。因此，*ASM* 已準備就緒以受惠於目前這充滿活力的市場環境。管理層深信 *ASM* 於二零零三年無論在營業額及盈利能力方面均可繼續超越同儕。

## 在聯交所網頁登載詳細的業績公告

本公司載有根據香港聯合交易所有限公司(聯交所)證券上市規則附錄十六第46(1)至46(6)段所規定的全部資料的業績公告將在適當時間在聯交所網頁登載。

## 審計委員會

審計委員會已與管理層檢閱本集團所採用的會計原則及常規，討論審核工作、內部控制及財務報表事宜，包括審查未經審核之中期財務報表。

承董事會命  
董事  
林師龐

香港，二零零三年七月二十八日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報及信報)刊登的內容。